

プラズマエッチングにおけるパーティクル・プロセス異常の 検出とプラズマ耐性材料とその評価技術

◆日時: 2025年12月09日(火) 13:00~17:00

◆会場: 【WEB限定セミナー】※在宅、会社にながらセミナーを受けられます

◆聴講料: 1名につき49,500円(税込、資料付)

※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

・1名でお申込みされた場合、1名につき**46,200円(税込)**・2名同時でお申し込みされた場合、**2人目は無料(2名で49,500円(税込))**

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師: (国研)産業技術総合研究所 先端半導体研究センター／センシング技術研究部門

主任研究員 博士(工学) 笠嶋 悠司 氏

現在、半導体は産業上の一部品としてではなく、経済安全保障にも関わる極めて重要な「特定重要物資」として取り扱われています。半導体製造技術の最先端では2nm、更にはより以細な製造技術の研究開発も進められています。その一方、我が国の半導体産業の特長の一つは、車載用マイコンやセンサ用半導体、パワー半導体をはじめとして最先端の微細製造技術を必ずしも必要としない半導体デバイスに競争力を有することです。本セミナーでは、後者の製造を担ういわゆるレガシーファブの量産ラインの前工程において、装置稼働率や歩留まりの向上に必要となる製造技術について紹介します。前工程の中でも、特に収益性に関わりが大きいプラズマエッチングプロセスに関し、不良発生の抑止やメンテナンス費用削減、装置機差の低減等に資する技術について解説します。

1. はじめに

1.1 半導体の製造工程とプラズマプロセスにおける課題

1.2 プラズマエッチングプロセス

2. プラズマエッチングプロセスにおけるパーティクル

2.1 パーティクル対策の必要性

2.2 パーティクルのその場検出手法

2.3 パーティクルの発生メカニズム

3. プラズマプロセスにおける異常モニタリング・検出技術

3.1 異常放電

3.2 各種モニタリング・検出手法(インピーダンス、電位プローブ、AE等)

4. プラズマ耐性材料とその評価技術

4.1 プロセスチャンバー用部品部材の腐食とパーティクル発生

4.2 高プラズマ耐性材料

4.3 チャンバー部品部材のプラズマ耐性評価(セラミックス部材を例として)

『プラズマエッチング【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

☐ Eメール☐ 郵送

● Webセミナーの受講申込みにについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたしまして、別途視聴用のURLをメールにお送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>